

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО  
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ  
И МЕТРОЛОГИИ  
(Росстандарт)

Пресненская набережная, 10, стр. 2, Москва,  
123112

Tel: +7 (495) 547-51-51



Приложение № 3  
к протоколу РГ МТК № 16-2025

MINISTRY OF INDUSTRY AND  
TRADE OF RUSSIAN FEDERATION

FEDERAL AGENCY  
ON TECHNICAL REGULATING  
AND METROLOGY  
(Rosstandart)

Presnenskaya embankment, 10-2, Moscow,  
Russia, 123112

<http://www.rst.gov.ru>

Fax: +7 (495) 547-51-60

13.10.2025г. № АМ-4361/03

Ответственному секретарю МГС,  
Директору Бюро по стандартам МГС

В.Н.Черняку

[easc@easc.org.by](mailto:easc@easc.org.by)

Уважаемый Владимир Николаевич!

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в соответствии с п. 5.2.1 и п. 5.2.4 ГОСТ 1.4-2020 «Межгосударственная система стандартизации. Межгосударственные технические комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности» направляет комплект документов по созданию МТК 567 «Сверхвысокочастотная и силовая электроника».

- Приложение:
1. Предложение по организации работы МТК на 3 л. в 1 экз.;
  2. Контактные данные на 1 л. в 1 экз.;
  3. Согласование области деятельности МТК на 3 л. в 1 экз.;
  4. Письма о статусе участия на 5 л. в 1 экз.;
  5. Письмо ТК 328 на 20 л. в 1 экз.;
  6. Проект перспективной программы по стандартизации (работ) МТК на 2 л. в 1 экз.;
  7. Проект положения МТК на 5 л. в 1 экз.;
  8. Перечень ГОСТ на 3 л. в 1 экз.

Руководитель

А.П. Шалаев

**Сведения с контактными данными о межгосударственном комитете по стандартизации  
№ 567 «Сверхвысокочастотная и силовая электроника» (МТК 567)**

№ п/п	Должность	Сведения
1.	Секретариат	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «Институт стандартизации»). Адрес местонахождения: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, дом 31, корпус 2; Адрес электронной почты: <a href="mailto:info@gostinfo.ru">info@gostinfo.ru</a> ; Телефон: +7 (495) 531-26-44
2.	Председатель	Рулевский Виктор Михайлович, ректор Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (ФГАОУ ВО «ТУСУР»); Адрес электронной почты: <a href="mailto:rector@tusur.ru">rector@tusur.ru</a> ; Телефон: +7 (3822) 51-05-30
3.	Заместитель председателя	Мурсалимова Нэля Витальевна, директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области» (ФБУ «Томский ЦСМ»); Адрес электронной почты: <a href="mailto:mursalimovanv@tcsms.tomsk.ru">mursalimovanv@tcsms.tomsk.ru</a> ; Телефон: +7 (3822) 55-44-86
4.	Заместитель председателя	Гаевой Евгений Васильевич, помощник ректора ФГАОУ ВО «ТУСУР», директор Центра коллективного проектирования «СВЧ микроэлектроника и радиофотоника»; Адрес электронной почты: <a href="mailto:gaevoye@mail.ru">gaevoye@mail.ru</a> ; Телефон: +7 913 850-99-95
5.	Ответственный секретарь	Лиепиньш Татьяна Викторовна, ведущий инженер по качеству ФБУ «Томский ЦСМ»; Адрес электронной почты: <a href="mailto:liepinshtv@tcsms.tomsk.ru">liepinshtv@tcsms.tomsk.ru</a> ; Телефон: +7 (3822) 55-44-86

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (РОССТАНДАРТ) –  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ  
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ  
МТК 037 «НИЗКОВОЛЬТНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ АППАРАТУРА И КОМПЛЕКТНЫЕ  
УСТРОЙСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ЗАЩИТЫ, УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ»**

125040, г. Москва, Ленинградский проспект 15 стр.20. +7 495 777 777 9  
e-mail: [tk331@dkc.ru](mailto:tk331@dkc.ru)

№ МТК037-38И25 от 29.08.2025

На 88/ТК-328 от 30 июль 2025

Председателю технического  
комитета по стандартизации  
ТК 328 «Сверхвысокочастотная  
и силовая электроника»

Тема:  
О согласовании кода области  
деятельности

**Уважаемый Виктор Михайлович!**

Рассмотрев письмо, направленное в адрес МТК 037 «Низковольтная коммутационная аппаратура и комплектные устройства распределения, защиты, управления и сигнализации», о согласовании расширения области деятельности создаваемого МТК «Сверхвысокочастотная и силовая электроника».

Сообщаем о согласовании расширения области деятельности создаваемого МТК «Сверхвысокочастотная и силовая электроника» в части кодов МКС 29.200 и МКС 29.100 со следующими формулировками:

- «МКС 29.200 Выпрямители. Преобразователи. Стабилизированные источники питания, включая полупроводниковые преобразователи (в части сверхвысокочастотной и силовой электроники)»;

- «МКС 29.100 Компоненты электрооборудования (в части сверхвысокочастотной и силовой электроники)».

С уважением,

**Председатель МТК 037**

«Низковольтная коммутационная  
аппаратура и комплектные устройства  
распределения, защиты, управления и  
сигнализации»



Р.Р. Ахмедшин

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ  
**МТК 296 «ОПТИКА И ФОТОНИКА»**

---

Секретариат:

Секретариат:

Общество с ограниченной ответственностью  
«Лазеры и оптические системы»  
199034, г. Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., д.5, литер Б, ком. 10  
Почтовый адрес: 199053 Россия, Санкт-Петербург, а/я 606  
Тел.: 8 (812) 334-08-22  
Эл. почта: s.valinchus@laser-physics.com

Председателю ТК328

**Рублевскому В.М.**

Исх. № 061МТК-09/25 от «23» сентября 2025 г.  
О согласовании области деятельности

**Уважаемый Виктор Михайлович!**

Секретариат МТК 296 рассмотрел предложение по организации МТК «Сверхвысокочастотная и силовая электроника» (исх. от 30.07.2025 № 86/ТК-328) и включению в область деятельности, деятельности по коду МКС 31.080.99 «Полупроводниковые приборы прочие» в части сверхвысокочастотной и силовой электроники.

В соответствии с п. 5.1 ГОСТ 1.4-2020 «Межгосударственная система стандартизации. Межгосударственные технические комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности» МТК 296 согласовывает область деятельности вновь создаваемого МТК «Сверхвысокочастотная и силовая электроника» код МКС 31.080.90 «Полупроводниковые приборы прочие» в части сверхвысокочастотной и силовой электроники.

Председатель МТК 296



И.В. Хлопонина

Федеральное агентство по техническому  
регулированию и метрологии



ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ  
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»  
(МТК 541/ ТК 016)



Базовая организация: АО «СО ЕЭС»  
Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3,  
Москва, Россия, 109012  
Тел.: (495) 627-95-66 Факс: (495) 627-95-15  
E-mail: tk16@so-ups.ru  
<http://www.so-ups.ru>

Председателю ТК 328  
«Сверхвысокочастотная  
и силовая электроника»  
Рулевскому В.М.

21.08.2025 № ТК016-исх-152

На № 87/ТК-328 от 30.07.2025

О согласовании кодов МКС и ОКС

Уважаемый Виктор Михайлович!

Сообщаю о согласии на включение в область деятельности формирующегося МТК «Сверхвысокочастотная и силовая электроника» кодов МКС 31.060 «Конденсаторы» и 31.080 «Полупроводниковые приборы» в части сверхвысокочастотной и силовой электроники.

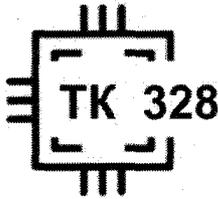
Рассмотрение проектов стандартов по смежной тематике при формировании и реализации планов работ ТК предлагаю проводить во взаимодействии секретариатов ТК.

Дополнительно сообщая, что код МКС 31.060 «Конденсаторы» закреплен за МТК 541 и не закреплен за ТК 016. С целью синхронизации кодов МКС и ОКС прошу согласовать включение в область деятельности ТК 016 кода ОКС 31.060.

Председатель МТК 541 / ТК 016

С.А. Павлушко

Березовский Петр Константинович  
(499) 788-19-69



**Технический комитет по стандартизации  
TK 328 «СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНАЯ И  
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА»**

электронная почта: [office@tusur.ru](mailto:office@tusur.ru), [info@tcsms.tomsk.ru](mailto:info@tcsms.tomsk.ru), [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)  
телефоны: (3822) 51-05-30, (3822) 55-44-86, (495) 531-26-44

---

№ 94/TK-328 от 24.09.2025

Начальнику Управления стандартизации  
Федерального агентства по техническому  
регулированию и метрологии  
И.А. Шуваловой

Уважаемая Ирина Александровна!

В целях организации работ по межгосударственной стандартизации в области сверхвысококачастотной и силовой электроники направляем на рассмотрение доработанные в соответствии с замечаниями Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь (исх. № 03-09/1209 от 22.07.2025) документы о создании межгосударственного технического комитета по стандартизации «Сверхвысококачастотная и силовая электроника».

Прошу Вас вынести вопрос о создании МТК на очередное заседание Рабочей группы по организации работ МТК (РГ МТК) Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации.

Приложение: Предложение по организации межгосударственного технического комитета по стандартизации, на 19 л., в 1 экз.

Зам. председателя ТК 328  
Директор ФБУ «Томский ЦСМ»

Н.В. Мурсалимова



№02-12-2833 от 23 июля 2025г.

**ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНСТВУ ПО  
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И  
МЕТРОЛОГИИ (Росстандарт)**

Российская Федерация, 123112,  
г. Москва, Пресненская набережная, 10, стр. 2  
электронная почта: info@rst.gov.ru

Уважаемый Антон Павлович!

Узбекский институт стандартов при Узбекском агентстве по техническому регулированию выражает признательность Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) за предложение в участии в работе МТК «Сверхвысокочастотная и силовая электроника» и намерен активизировать усилия по улучшению межгосударственных стандартов в области сверхвысокочастотной и силовой электроники.

Республика Узбекистан в лице Национального органа по стандартизации Узбекского института стандартов при Агентстве технического регулирования Кабинета Министров Республики Узбекистан изъявляет своё желание стать наблюдателем МТК «Сверхвысокочастотная и силовая электроника». Для плановой работы межгосударственного технического комитета по стандартизации предлагаем включить нижеприведенную кандидатуру от Республики Узбекистан в состав МТК «Сверхвысокочастотная и силовая электроника» в качестве наблюдателя.

Юсупов Элмурод Турдалиевич (Наблюдатель) – Докторант (PhD) института проблем энергетики Академии наук Республики Узбекистан  
тел: +998 97 423 54 99, эл. почта: yunusov.e.t@gmail.com

**Первый заместитель  
Директора**



**А. Закиров**



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

22.07.2025 № 03-09/1209  
на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Федеральное агентство по  
техническому  
регулированию и метрологии

### О создании МТК

Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь рассмотрел письмо от Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (исх. АШ-2748/03 от 04.07.2025) об участии Республики Беларусь в создаваемом межгосударственном техническом комитете по стандартизации МТК «Сверхвысокочастотная и силовая электроника» (далее- МТК), сообщает следующее.

Организации Республики Беларусь заинтересованы в работе создаваемого МТК.

Республика Беларусь примет участие в создаваемом МТК в качестве полноправного члена (Р-член).

Контактные данные эксперта для участия в работах МТК в качестве полномочного представителя будут направлены позже.

Дополнительно сообщаем, что по результатам рассмотрения представленного комплекта документов по созданию МТК, имеются следующие замечания и предложения.

В соответствии с требованиями ГОСТ 1.4-2020 «Межгосударственная система стандартизации. Межгосударственные технические комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности» область деятельности создаваемого МТК не должна дублировать области деятельности уже существующих МТК, а у создаваемого МТК дублируются следующие коды МКС:

так как указан групповой код МКС 29.100, то подгрупповые коды 29.100.01, 29.100.20 и 29.100.99 с МТК 37 «Низковольтная коммутационная аппаратура и комплектные устройства распределения, защиты, управления и сигнализации»;

29.200 с МТК 37;

31.060, 31.080 с МТК 541 «Электроэнергетика» и 31.080.99 с МТК 296 «Оптика и фотоника».

В связи с тем, что область деятельности создаваемого МТК дублируется с существующими МТК, то в соответствии с требованиями ГОСТ 1.4-2020 необходимо провести консультации с такими МТК на предмет разграничения областей деятельности.

В проекте перспективной программы по стандартизации (работ) межгосударственного комитета по стандартизации 328 «Сверхвысокочастотная и силовая электроника» в пунктах 5 и 6 указано, что будет проводиться пересмотр ГОСТ 18604.15-77, а наименование стандартов разное.

Обращаем внимание, что в Перечень межгосударственных стандартов, которые предполагается разработать или обновить в области деятельности МТК в ближайшие годы, включены работы по пересмотру ГОСТ 21702-76 и ГОСТ 23221-78, имеющих код МКС 01.040.33, который отсутствует в области деятельности создаваемого МТК.

В соответствии с требованиями ГОСТ 1.4-2020 при регистрации МТК присваивают обозначение, которое включает индекс «МТК» и идентификационный номер, являющийся следующим в порядке возрастания после номера последнего ранее зарегистрированного МТК. Следовательно, создаваемый МТК не может иметь обозначение МТК 328.

Исходя из вышеизложенного считаем, что представленный комплект документов требует доработки в части уточнения его области деятельности и получения согласования соответствующих МТК.

Первый заместитель  
Председателя



А.А.Бурак

09/10.10



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

10.10.2025 № 03-09/1801  
на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Федеральное агентство по  
техническому  
регулированию и метрологии

О статусе участия

Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь в ответ на письмо Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (исх. от 04.07.2025 № АШ-2748/03) и в дополнение к письму Госстандарта (от 21.07.2025 № 03-09/1209) об участии Республики Беларусь в создаваемом межгосударственном техническом комитете по стандартизации МТК «Сверхвысокочастотная и силовая электроника» (далее- МТК), сообщает следующее.

Республика Беларусь примет участие в создаваемом МТК в качестве полноправного члена (Р-член).

Контактные данные эксперта для участия в работах МТК в качестве полномочного представителя: Ильянкова Ольга Федоровна – заместитель директора по техническому нормированию, стандартизации и методологии оценки соответствия, научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», тел. +375 17 269 69 99, e-mail: info@belgiss.by.

Первый заместитель  
Председателя

А.А.Бурак



« 10 » июля 2025թ. НЭСМ-1011

РУКОВОДИТЕЛЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССТАНДАРТ)  
Г-НУ ШАЛАЕВУ АНТОНУ ПАВЛОВИЧУ  
(эл. адрес: [info@rst.gov.ru](mailto:info@rst.gov.ru))

**Уважаемый Антон Павлович!**

В ответ на Ваше письмо от 04 июля 2025 года АИП-2748/03 ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения направляет кандидатуру полномочного представителя с целью участия Республики Армения в качестве полноправного члена в деятельности межгосударственного технического комитета по стандартизации «Сверхвысокочастотная и силовая электроника»: Бабаджанян Владислав Владимирович – эксперт в лаборатории радиоэлектронных измерений ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» РА.

Контактные данные:

Адрес: Республика Армения, 0051, г. Ереван, пр. Комитаса 49/4

Моб. тел.: +374 95729004

Эл. почта: [ybabajanyan@armstandard.am](mailto:ybabajanyan@armstandard.am)

С уважением,  
врио директора

БАБАЯН А.А.

исп.: Бабаян Т.П.  
тел.: (+374 10) 23-26-00 (224)  
эл. почта: [tbabayan@armstandard.am](mailto:tbabayan@armstandard.am)

*Исп.: С. Шокаримов*  
*Тел.: (71) 253 18 47*

## **ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**по организации межгосударственного технического комитета по стандартизации**

### **1 Наименование МТК:**

«Сверхвысококачественная и силовая электроника»

### **2 Область деятельности МТК с указанием кодов МК (ИСО/ИНФКО МКС):**

29.100 Компоненты электрооборудования (в части сверхвысококачественной и силовой электроники)

29.200 Выпрямители. Преобразователи. Стабилизированные источники питания, включая полупроводниковые преобразователи (в части сверхвысококачественной и силовой электроники)

31.020 Электронные компоненты в целом (в части сверхвысококачественной и силовой электроники)

31.040 Резисторы (в части сверхвысококачественной и силовой электроники)

31.060 Конденсаторы (в части сверхвысококачественной и силовой электроники)

31.080 Полупроводниковые приборы

31.200 Интегральные схемы. Микроэлектроника, включая электронные микросхемы, логические и аналоговые микроструктуры

### **3 Структура МТК:**

Наличие ПК не предусмотрено.

**4 Номер и наименование технического комитета (его подкомитета) международной или европейской организации по стандартизации и (или) национального ТК государства – участника Соглашения с идентичной областью деятельности (при наличии):**

- МЭК/ТК 22 «Системы и оборудование силовой электроники»;
- МЭК/ТК 40 «Конденсаторы и резисторы для электронной аппаратуры»;
- МЭК/ТК 47 «Полупроводниковые устройства».

**5 Наименование организации, которой предлагается поручить ведение секретариата МТК и область ее деятельности:**

**Полное наименование:** Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский институт стандартизации».

**Сокращенное наименование:** ФГБУ «Институт стандартизации».

ФГБУ «Институт стандартизации» является государственным центром компетенций в области стандартизации и технического регулирования.

Основные направления деятельности ФГБУ «Институт стандартизации»:

- формирование и ведение Федерального информационного фонда стандартов;
- реализация Программы национальной стандартизации;
- проведение экспертизы документов по стандартизации – в том числе, в части документов по стандартизации оборонной продукции;
- информационное обеспечение национальной системы стандартизации;
- обеспечение разработки, ведения и применения общероссийских классификаторов;
- проведение работ по международной и региональной стандартизации;
- создание и ведение федеральных информационных систем;
- ведение секретариатов технических комитетов по стандартизации (ТК) и межгосударственных технических комитетов по стандартизации (МТК);
- кураторство ТК в целях осуществления содействия соблюдению техническими комитетами по стандартизации требований ГОСТ Р 1.1–2020, а также иных основополагающих стандартов и правил стандартизации;

- перспективное планирование, разработка и информационно-методическое сопровождение разработки национальных, региональных и международных документов по стандартизации;  
- предоставление разъяснений по применению документов по стандартизации.  
ФГБУ «Институт стандартизации» ведет секретариат зеркального создаваемому МТК – ТК 328 «Сверхвысокочастотная и силовая электроника».

**6 Предложения по кандидатурам председателя МТК, его заместителя (при необходимости) и ответственного секретаря комитета и обоснование их компетентности и опыта работы в области деятельности создаваемого МТК и в сфере стандартизации:**

Председатель МТК – ректор Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (ФГАОУ ВО «ТУСУР»), председатель ТК 328 «Сверхвысокочастотная и силовая электроника» – Рулевский Виктор Михайлович.

Заместитель председателя МТК – директор Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области» (ФБУ «Томский ЦСМ»), заместитель председателя ТК 328 «Сверхвысокочастотная и силовая электроника» – Мурсалимова Нэлла Витальевна.

Заместитель председателя МТК – помощник ректора Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (ФГАОУ ВО «ТУСУР»), директор Центра коллективного проектирования «СВЧ микроэлектроника и радиофотоника», заместитель председателя ТК 328 «Сверхвысокочастотная и силовая электроника» – Гаевой Евгений Васильевич.

Ответственный секретарь МТК – ведущий инженер по качеству Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области» (ФБУ «Томский ЦСМ»), ответственный секретарь ТК 328 «Сверхвысокочастотная и силовая электроника» – Лиепиньш Татьяна Викторовна.

**7 Номер контактного телефона, адрес электронной почты в Интернете и данные лица, ответственного за формирование МТК:**

Лиепиньш Татьяна Викторовна, тел. +7 (382-2) 55-44-86, +7 913 849 11 82, liepinshtv@tcsms.tomsk.ru, г. Томск, ул. Косарева, 17а.

**Перечень существующих межгосударственных стандартов, которые предлагается закрепить за МТК**

представлен в Приложении № 1

**Перечень межгосударственных стандартов, которые предполагается разработать или обновить в области деятельности МТК в ближайшие годы**

представлен в Приложении № 2

**Перечень международных (и/или европейских) стандартов:**

представлен в Приложении № 3

**Перечень существующих межгосударственных стандартов, которые предлагается  
закрепить за МТК**

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
1	ГОСТ 4.137-85	Система показателей качества продукции. Приборы полупроводниковые силовые. Номенклатура показателей
2	ГОСТ 4.172-85	Система показателей качества продукции. Конденсаторы силовые, установки конденсаторные. Номенклатура показателей
3	ГОСТ 18604.13-77	Транзисторы биполярные СВЧ генераторные. Методы измерения выходной мощности и определения коэффициента усиления по мощности и коэффициента полезного действия коллектора
4	ГОСТ 18604.14-77	Транзисторы биполярные СВЧ генераторные. Метод измерения модуля коэффициента обратной передачи напряжения в схеме с общей базой на высокой частоте
5	ГОСТ 18604.15-77	Транзисторы биполярные СВЧ генераторные. Методы измерения критического тока
6	ГОСТ 19656.0-74	Диоды полупроводниковые СВЧ. Методы измерения электрических параметров. Общие положения
7	ГОСТ 19656.1-74	Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные и детекторные. Метод измерения коэффициента стоячей волны по напряжению
8	ГОСТ 19656.2-74	Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные. Метод измерения выпрямленного тока
9	ГОСТ 19656.3-74	Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные. Методы измерения выходного сопротивления на промежуточной частоте
10	ГОСТ 19656.4-74	Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные. Методы измерения потерь преобразования
11	ГОСТ 19656.5-74	Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные и детекторные. Методы измерения шумового отношения
12	ГОСТ 19656.6-74	Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные. Методы измерения нормированного коэффициента шума
13	ГОСТ 19656.7-74	Диоды полупроводниковые СВЧ детекторные. Метод измерения чувствительности по току
14	ГОСТ 19656.9-79	Диоды полупроводниковые СВЧ параметрические и умножительные. Методы измерения постоянной времени и предельной частоты
15	ГОСТ 19656.10-88	Диоды полупроводниковые сверхвысокочастотные переключательные и ограничительные. Методы измерения сопротивлений потерь
16	ГОСТ 19656.12-76	Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные. Метод измерения полного входного сопротивления

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
17	ГОСТ 19656.13-76	Диоды полупроводниковые СВЧ детекторные. Методы измерения тангенциальной чувствительности
18	ГОСТ 19656.14-79	Диоды полупроводниковые СВЧ переключательные. Метод измерения критической частоты
19	ГОСТ 19656.15-84	Диоды полупроводниковые СВЧ. Методы измерения теплового сопротивления переход-корпус и импульсного теплового сопротивления
20	ГОСТ 19656.16-86	Диоды полупроводниковые СВЧ ограничительные. Метод измерения пороговой и просачивающейся мощностей
21	ГОСТ 20215-84	Диоды полупроводниковые сверхвысокочастотные. Общие технические условия
22	ГОСТ 20271.1-91	Изделия электронные СВЧ. Методы измерения электрических параметров
23	ГОСТ 20271.3-91	Изделия электронные СВЧ. Методы измерения параметров модулирующего импульса
24	ГОСТ 20859.1-89	Приборы полупроводниковые силовые. Общие технические требования
25	ГОСТ 21702-76	Устройства СВЧ. Полосковые линии. Термины и определения
26	ГОСТ 23221-78	Модули СВЧ, блоки СВЧ. Термины, определения и буквенные обозначения
27	ГОСТ 23769-79	Приборы электронные и устройства защитные СВЧ. Термины, определения и буквенные обозначения
28	ГОСТ 23900-87	Приборы полупроводниковые силовые. Габаритные и присоединительные размеры
29	ГОСТ 24461-80	Приборы полупроводниковые силовые. Методы измерений и испытаний
30	ГОСТ 27264-87	Транзисторы силовые биполярные. Методы измерений
31	ГОСТ 27591-88	Модули полупроводниковые силовые. Габаритные и присоединительные размеры
32	ГОСТ 29002-91 (МЭК 723-4-87)	Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, применяемых в аппаратуре дальней связи. Часть 4. Групповые технические условия на сердечники из магнитных оксидных материалов для трансформаторов и дросселей, предназначенных для применения в силовых устройствах
33	ГОСТ 29003-91 (МЭК 723-4-1-87)	Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, применяемых в аппаратуре дальней связи. Часть 4. Форма технических условий на сердечники конкретных типов из магнитных оксидных материалов для трансформаторов и дросселей, предназначенных для применения в силовых устройствах. Уровень качества А
34	ГОСТ 30617-98	Модули полупроводниковые силовые. Общие технические условия

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
35	ГОСТ IEC 60931-1-2013	Конденсаторы шунтирующие силовые несамовосстанавливающегося типа для систем переменного тока на номинальное напряжение до 1000 В включительно. Часть 1. Общие положения. Рабочие характеристики, испытания и номинальные параметры. Требования техники безопасности. Руководство по установке и эксплуатации
36	ГОСТ IEC 60931-2-2013	Конденсаторы шунтирующие силовые несамовосстанавливающиеся для систем с переменным током и номинальным напряжением до 1000 В включительно. Часть 2. Испытание на старение и испытание на разрушение
37	ГОСТ IEC 60931-3-2013	Конденсаторы шунтирующие силовые несамовосстанавливающиеся для систем переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В включительно. Часть 3. Внутренние плавкие предохранители
38	ГОСТ IEC 61071-2014	Конденсаторы силовые электронные
39	ГОСТ IEC 61921-2013	Конденсаторы силовые. Конденсаторные батареи для коррекции коэффициента мощности при низком напряжении

**Перечень межгосударственных стандартов, которые предполагается разработать или обновить в области деятельности МТК в ближайшие годы**

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Вид работ
1		Технологии АЗБ5. Пластины с кристаллами заказных элементов. Термины и определения	Разработка ГОСТ на основе ГОСТ Р 71584-2024
2		Устройства преобразования энергии на основе нитрида галлия. Методы оценки срока службы. Общие положения	Разработка ГОСТ на основе ГОСТ Р 71548-2024
3		Устройства преобразования энергии на основе нитрида галлия. Метод измерений для оценки непрерывного переключения	Разработка ГОСТ на основе ГОСТ Р 71155-2023
4	ГОСТ 18604.13	Транзисторы биполярные СВЧ генераторные. Методы измерения выходной мощности и определения коэффициента усиления по мощности и коэффициента полезного действия коллектора	Пересмотр ГОСТ 18604.13-77
5	ГОСТ 18604.14	Транзисторы биполярные СВЧ генераторные. Метод измерения модуля коэффициента обратной передачи напряжения в схеме с общей базой на высокой частоте	Пересмотр ГОСТ 18604.14-77
6	ГОСТ 18604.15	Транзисторы биполярные СВЧ генераторные. Методы измерения критического тока	Пересмотр ГОСТ 18604.15-77
7	ГОСТ 19656.0	Диоды полупроводниковые СВЧ. Методы измерения электрических параметров. Общие положения	Пересмотр ГОСТ 19656.0-74
8	ГОСТ 20215	Диоды полупроводниковые сверхвысокочастотные. Общие технические условия	Пересмотр ГОСТ 20215-84
9	ГОСТ 21702	Устройства СВЧ. Полосковые линии. Термины и определения	Пересмотр ГОСТ 21702-76
10	ГОСТ 23221	Модули СВЧ, блоки СВЧ. Термины, определения и буквенные обозначения	Пересмотр ГОСТ 23221-78

Перечень международных (и/или европейских) стандартов

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
TC 22 Power electronic systems and equipment Системы и оборудование силовой электроники		
1.	IEC 60146-1-1:2024	Semiconductor converters - General requirements and line commutated converters - Part 1-1: Specification of basic requirements
2.	IEC TR 60146-1-2:2019	Semiconductor converters - General requirements and line commutated converters - Part 1-2: Application guidelines
3.	IEC 60146-2:1999	Semiconductor converters - Part 2: Self-commutated semiconductor converters including direct d.c. converters
4.	IEC 61148:2011	Terminal markings for valve device stacks and assemblies and for power conversion equipment
5.	IEC 62477-1:2022	Safety requirements for power electronic converter systems and equipment - Part 1: General
6.	IEC 62477-2:2018	Safety requirements for power electronic converter systems and equipment - Part 2: Power electronic converters from 1 000 V AC or 1 500 V DC up to 36 kV AC or 54 kV DC
7.	IEC TS 62578:2015	Power electronics systems and equipment - Operation conditions and characteristics of active infeed converter (AIC) applications including design recommendations for their emission values below 150 kHz
TC 40 Capacitors and resistors for electronic equipment Конденсаторы и резисторы для электронной аппаратуры		
8.	IEC 60062:2016 + AMD1:2019	Marking codes for resistors and capacitors
9.	IEC 60063:2015	Preferred number series for resistors and capacitors
10.	IEC 60115-1:2020	Fixed resistors for use in electronic equipment - Part 1: Generic specification
11.	IEC 60115-2:2023	Fixed resistors for use in electronic equipment - Part 2: Sectional specification: Low-power film resistors with leads for through-hole assembly on circuit boards (THT)
12.	IEC 60115-2-10:2023	Fixed resistors for use in electronic equipment - Part 2-10: Blank detail specification: Low-power film resistors with leads for through-hole assembly on circuit boards (THT), for general electronic equipment, classification level G
13.	IEC 60115-4:2022	Fixed resistors for use in electronic equipment - Part 4: Sectional specification: Power resistors for through hole assembly on circuit boards (THT) or for assembly on chassis
14.	IEC 60115-4-10:2023	Fixed resistors for use in electronic equipment - Part 4-10: Blank detail specification: Power resistors with axial leads for through-hole assembly on circuit boards (THT), for general electronic equipment, classification level G

15.	IEC 60115-6:1983 +AMD1:1987	Fixed resistors for use in electronic equipment. Part 6: Sectional specification Fixed resistor networks with individually measurable resistors
16.	IEC 60115-6-1:1983	Fixed resistors for use in electronic equipment. Part 6: Blank detail specification: Fixed resistor networks with individually measurable resistors, all of equal value and equal dissipation. Assessment level E
17.	IEC 60115-7:1984	Fixed resistors for use in electronic equipment. Part 7: Sectional specification: Fixed resistor networks in which not all resistors are individually measurable
18.	IEC 60115-7-1:1984	Fixed resistors for use in electronic equipment. Part 7: Blank detail specifications: Fixed resistors networks in which not all resistors are individually measurable. Assessment level E
19.	IEC 60115-8:2023	Fixed resistors for use in electronic equipment - Part 8: Sectional specification: Fixed surface mount resistors
20.	IEC 60115-8-1:2014	Fixed resistors for use in electronic equipment - Part 8-1: Blank detail specification: Fixed surface mount (SMD) low power film resistors for general electronic equipment, classification level G
21.	IEC 60115-9:2003	Fixed resistors for use in electronic equipment - Part 9: Sectional specification: Fixed surface mount resistor networks with individually measurable resistors
22.	IEC 60115-9-1:2003	Fixed resistors for use in electronic equipment - Part 9-1: Blank detail specification: Fixed surface mount resistor networks with individually measurable resistors - Assessment level EZ
23.	IEC 60195:2016	Method of measurement of current noise generated in fixed resistors
24.	IEC 60286-1:2017 +AMD1:2021	Packaging of components for automatic handling - Part 1: Tape packaging of components with axial leads on continuous tapes
25.	IEC 60286-2:2022	Packaging of components for automatic handling - Part 2: Tape packaging of components with unidirectional leads on continuous tapes
26.	IEC 60286-3:2022	Packaging of components for automatic handling - Part 3: Packaging of surface mount components on continuous tapes
27.	IEC TR 60286-3-3:2021	Packaging of components for automatic handling - Part 3-3: Packaging of surface mount components on continuous paper tapes for Auto Loading Feeder
28.	IEC TR 60286-3-4:2021	Packaging of components for automatic handling - Part 3-4: Packaging of surface mount components on continuous embossed tapes for Auto Loading Feeder
29.	IEC 60286-4:2013	Packaging of components for automatic handling - Part 4: Stick magazines for electronic components encapsulated in packages of different forms
30.	IEC 60286-5:2018	Packaging of components for automatic handling - Part 5: Matrix trays
31.	IEC 60286-6:2004	Packaging of components for automatic handling - Part 6: Bulk case packaging for surface mounting components
32.	IEC TS 60286-6-1:2023	Packaging of components for automatic handling - Part 6-1: Bulk case packaging for miniaturized surface mounting components

33.	IEC TR 60286-7:2019	Packaging of components for automatic handling - Part 7: Introduction of a bulk blister pack for miniaturized components
34.	IEC 60294:2012	Measurement of the dimensions of a cylindrical component with axial terminations
35.	IEC 60301:2012	Preferred diameters of wire terminations of capacitors and resistors
36.	IEC 60384-1:2021	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 1: Generic specification
37.	IEC 60384-1-1:2022	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 1-1: Generic blank detail specification
38.	IEC 60384-2:2021	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 2: Sectional specification - Fixed metallized polyethylene terephthalate film dielectric DC capacitors
39.	IEC 60384-2-1:2005	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 2-1: Blank detail specification: Fixed metallized polyethylene-terephthalate film dielectric d.c. capacitors - Assessment levels E and EZ
40.	IEC 60384-3:2016	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 3: Sectional specification - Surface mount fixed tantalum electrolytic capacitors with solid (MnO <sub>2</sub> ) electrolyte
41.	IEC 60384-3-1:2006	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 3-1: Blank detail specification: Surface mount fixed tantalum electrolytic capacitors with manganese dioxide solid electrolyte - Assessment level EZ
42.	IEC 60384-3-101:1995	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 3-101: Detail specification: Fixed tantalum chip capacitors for surface mounting with solid electrolyte and porous anode, style I. Assessment level E
43.	IEC 60384-4:2016	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 4: Sectional specification - Fixed aluminium electrolytic capacitors with solid (MnO <sub>2</sub> ) and non-solid electrolyte
44.	IEC 60384-4-1:2007	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 4-1: Blank detail specification - Fixed aluminium electrolytic capacitors with non-solid electrolyte - Assessment level EZ
45.	IEC 60384-4-2:2007	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 4-2: Blank detail specification - Fixed aluminium electrolytic capacitors with solid (MnO <sub>2</sub> ) electrolyte - Assessment level EZ
46.	IEC 60384-8:2024	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 8: Sectional specification - Fixed capacitors of ceramic dielectric, Class 1
47.	IEC 60384-9:2024	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 9: Sectional specification - Fixed capacitors of ceramic dielectric, Class 2
48.	IEC 60384-11:2019	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 11: Sectional specification - Fixed polyethylene-terephthalate film dielectric metal foil DC capacitors
49.	IEC 60384-11-1:2008	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 11-1: Blank detail specification - Fixed polyethylene terephthalate film dielectric metal foil d.c. capacitors - Assessment level EZ

50.	IEC 60384-13:2020	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 13: Sectional specification - Fixed polypropylene film dielectric metal foil d.c. capacitors
51.	IEC 60384-13-1:2006	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 13-1: Blank detail specification - Fixed polypropylene film dielectric metal foil d.c. capacitors - Assessment level E and EZ
52.	IEC 60384-14:2023	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 14: Sectional specification - Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains
53.	IEC 60384-14-1:2016	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 14-1: Blank detail specification - Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains - Assessment level DZ
54.	IEC 60384-14-2:2016	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 14-2: Blank detail specification - Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains - Safety tests only
55.	IEC 60384-15:2017	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 15: Sectional specification: Fixed tantalum capacitors with non-solid or solid electrolyte
56.	IEC 60384-15-1:1984	Fixed capacitors for use in electronic equipment. Part 15: Blank detail specification: Fixed tantalum capacitors with non-solid electrolyte and foil electrode. Assessment level E
57.	IEC 60384-15-2:1984	Fixed capacitors for use in electronic equipment. Part 15: Blank detail specification: Fixed tantalum capacitors with non-solid electrolyte and process anode. Assessment level E
58.	IEC 60384-15-3:1984 +AMD1:1992	Fixed capacitors for use in electronic equipment. Part 15: Blank detail specification: Fixed tantalum capacitors with solid electrolyte and porous anode. Assessment level E
59.	IEC 60384-16:2019	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 16: Sectional specification - Fixed metallized polypropylene film dielectric DC capacitors
60.	IEC 60384-16-1:2005	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 16-1: Blank detail specification: Fixed metallized polypropylene film dielectric d.c. capacitors - Assessment levels E and EZ
61.	IEC 60384-17:2019	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 17: Sectional specification - Fixed metallized polypropylene film dielectric AC and pulse capacitors
62.	IEC 60384-17-1:2005	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 17-1: Blank detail specification: Fixed metallized polypropylene film dielectric a.c. and pulse capacitors - Assessment levels E and EZ
63.	IEC 60384-18:2016	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 18: Sectional specification - Fixed aluminium electrolytic surface mount capacitors with solid (MnO <sub>2</sub> ) and non-solid electrolyte
64.	IEC 60384-18-1:2007	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 18-1: Blank detail specification - Fixed aluminium electrolytic surface mount capacitors with solid (MnO <sub>2</sub> ) electrolyte - Assessment level EZ

65.	IEC 60384-18-2:2007	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 18-2: Blank detail specification - Fixed aluminium electrolytic surface mount capacitors with non-solid electrolyte - Assessment level EZ
66.	IEC 60384-19:2022	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 19: Sectional specification: Fixed metallized polyethylene terephthalate film dielectric surface mount DC capacitors
67.	IEC 60384-20:2023	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 20: Sectional specification - Fixed metallized polyphenylene sulfide film dielectric surface mount DC capacitors
68.	IEC 60384-21:2024	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 21: Sectional specification - Fixed surface mount multilayer capacitors of ceramic dielectric, Class 1
69.	IEC 60384-22:2024	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 22: Sectional specification - Fixed surface mount multilayer capacitors of ceramic dielectric, Class 2
70.	IEC 60384-23:2023	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 23: Sectional specification - Fixed metallized polyethylene naphthalate film dielectric surface mount DC capacitors
71.	IEC 60384-24:2021	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 24: Sectional specification - Fixed tantalum electrolytic surface mount capacitors with conductive polymer solid electrolyte
72.	IEC 60384-24-1:2006	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 24-1: Blank detail specification - Surface mount fixed tantalum electrolytic capacitors with conductive polymer solid electrolyte - Assessment level EZ
73.	IEC 60384-25:2021	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 25: Sectional specification - Fixed aluminium electrolytic surface mount capacitors with conductive polymer solid electrolyte
74.	IEC 60384-25-1:2006	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 25-1: Blank detail specification - Surface mount fixed aluminium electrolytic capacitors with conductive polymer solid electrolyte - Assessment level EZ
75.	IEC 60384-26:2018	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 26: Sectional specification - Fixed aluminium electrolytic capacitors with conductive polymer solid electrolyte
76.	IEC 60384-26-1:2010	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 26-1: Blank detail specification - Fixed aluminium electrolytic capacitors with conductive polymer solid electrolyte - Assessment level EZ
77.	IEC 60393-1:2008	Potentiometers for use in electronic equipment - Part 1: Generic specification
78.	IEC 60393-2:2015	Potentiometers for use in electronic equipment - Part 2: Sectional specification - Lead-screw actuated and rotary preset potentiometers
79.	IEC 60393-3:2023	Potentiometers for use in electronic equipment - Part 3: Sectional specification: Rotary precision potentiometers
80.	IEC 60393-4:2023	Potentiometers for use in electronic equipment - Part 4: Sectional specification: Single-turn rotary power potentiometers

81.	IEC 60393-5:2015	Potentiometers for use in electronic equipment - Part 5: Sectional specification - Single-turn rotary low-power wirewound and non-wirewound potentiometers
82.	IEC 60393-6:2015	Potentiometers for use in electronic equipment - Part 6: Sectional specification - Surface mount preset potentiometers
83.	IEC 60440:2012	Method of measurement of non-linearity in resistors
84.	IEC 60539-1:2022	Directly heated negative temperature coefficient thermistors - Part 1: Generic specification
85.	IEC 60539-2:2019	Directly heated negative temperature coefficient thermistors - Part 2: Sectional specification - Surface mount negative temperature coefficient thermistors
86.	IEC 60717:2012	Method for the determination of the space required by capacitors and resistors with unidirectional terminations
87.	IEC 60738-1:2022	Thermistors - Directly heated positive temperature coefficient - Part 1: Generic specification
88.	IEC 60738-1-1:2008	Thermistors - Directly heated positive step-function temperature coefficient - Part 1-1: Blank detail specification - Current limiting application - Assessment level EZ
89.	IEC 60738-1-2:2008	Thermistors - Directly heated positive step-function temperature coefficient - Part 1-2: Blank detail specification - Heating element application - Assessment level EZ
90.	IEC 60738-1-3:2008	Thermistors - Directly heated positive step-function temperature coefficient - Part 1-3: Blank detail specification - Inrush current application - Assessment level EZ
91.	IEC 60738-1-4:2008	Thermistors - Directly heated positive step-function temperature coefficient - Part 1-4: Blank detail specification - Sensing application - Assessment level EZ
92.	IEC 60915:2006	Capacitors and resistors for use in electronic equipment - Preferred dimensions of shaft ends, bushes and for the mounting of single-hole, bush-mounted, shaft-operated electronic components
93.	IEC 60938-1:2021	Fixed inductors for electromagnetic interference suppression - Part 1: Generic specification
94.	IEC 60938-2:2021	Fixed inductors for electromagnetic interference suppression - Part 2: Sectional specification on power line chokes
95.	IEC 60938-2-1:2023	Fixed inductors for electromagnetic interference suppression - Part 2-1: Blank detail specification - Inductors for which safety tests are required
96.	IEC 60939-1:2010	Passive filter units for electromagnetic interference suppression - Part 1: Generic specification
97.	IEC 60939-2:2005 +AMD1:2023	Passive filter units for electromagnetic interference suppression - Part 2: Sectional specification - Passive filter units for which safety tests are appropriate - Test methods and general requirements
98.	IEC 60939-2-1:2004	Complete filter units for radio interference suppression - Part 2-1: Blank detail specification - Passive filter units for electromagnetic interference suppression - Filters for which safety tests are required (assessment level D/DZ)
99.	IEC 60939-2-2:2004	Complete filter units for radio interference suppression - Part 2-2: Blank detail specification - Passive filter units for electromagnetic interference suppression - Filters for which safety tests are required (safety tests only)

100.	IEC 60939-3:2024	Passive filter units for electromagnetic interference suppression - Part 3: Passive filter units for which safety tests are appropriate
101.	IEC 60940:2015	Guidance information on the application of capacitors, resistors, inductors and complete filter units for electromagnetic interference suppression
102.	IEC 61051-1:2018	Varistors for use in electronic equipment - Part 1: Generic specification
103.	IEC 61051-2:2021	Varistors for use in electronic equipment - Part 2: Sectional specification for surge suppression varistors
104.	IEC 61051-2-2:1991	Varistors for use in electronic equipment - Part 2: Blank detail specification for zinc oxide surge suppression varistors. Assessment level E
105.	IEC 62319-1:2005	Polymeric thermistors - Directly heated positive step function temperature coefficient - Part 1: Generic specification
106.	IEC 62319-1-1:2005	Polymeric thermistors - Directly heated positive step function temperature coefficient - Part 1-1: Blank detail specification - Current limiting application
107.	IEC 62391-1:2022	Fixed electric double-layer capacitors for use in electric and electronic equipment - Part 1: Generic specification
108.	IEC 62391-2:2025	Fixed electric double-layer capacitors for use in electric and electronic equipment - Part 2: Sectional specification - Electric double-layer capacitors for power application
109.	IEC 62391-2-1:2006	Fixed electric double-layer capacitors for use in electronic equipment - Part 2-1: Blank detail specification - Electric double-layer capacitors for power application - Assessment level EZ
110.	IEC 62490-1:2010	ESL measuring method - Part 1: Capacitors with lead terminal for use in electronic equipment
111.	IEC 62490-2:2010	ESL measuring method - Part 2: Surface mount capacitors for use in electronic equipment
112.	IEC 62812:2019	Low resistance measurements - Methods and guidance
113.	IEC 62813:2025	Lithium ion capacitors for use in electric and electronic equipment - Test methods for electrical characteristics
114.	IEC TR 63091:2017	Study for the derating curve of surface mount fixed resistors - Derating curves based on terminal part temperature
115.	IEC TS 63337:2024	Basic qualification of DC-link film capacitors for automotive use - General requirements, test conditions and tests
116.	IEC TR 63362-1:2022	Application of fixed capacitors in electronic equipment - Part 1: Aluminium electrolytic capacitors
TC 47		
Semiconductor devices		
Полупроводниковые устройства		
117.	IEC 60747-1:2006 +AMD1:2010	Semiconductor devices - Part 1: General
118.	IEC 60749-1:2002	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 1: General

119.	IEC 60749-2:2002	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 2: Low air pressure
120.	IEC 60749-3:2017	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 3: External visual examination
121.	IEC 60749-4:2017	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 4: Damp heat, steady state, highly accelerated stress test (HAST)
122.	IEC 60749-5:2023	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 5: Steady-state temperature humidity bias life test
123.	IEC 60749-6:2017	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 6: Storage at high temperature
124.	IEC 60749-7:2011	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 7: Internal moisture content measurement and the analysis of other residual gases
125.	IEC 60749-8:2002	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 8: Sealing
126.	IEC 60749-9:2017	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 9: Permanence of marking
127.	IEC 60749-10:2022	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 10: Mechanical shock - device and subassembly
128.	IEC 60749-11:2002	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 11: Rapid change of temperature - Two-fluid-bath method
129.	IEC 60749-12:2017	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 12: Vibration, variable frequency
130.	IEC 60749-13:2018	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 13: Salt atmosphere
131.	IEC 60749-14:2003	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 14: Robustness of terminations (lead integrity)
132.	IEC 60749-15:2020	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 15: Resistance to soldering temperature for through-hole mounted devices
133.	IEC 60749-16:2003	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 16: Particle impact noise detection (PIND)
134.	IEC 60749-17:2019	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 17: Neutron irradiation
135.	IEC 60749-18:2019	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 18: Ionizing radiation (total dose)
136.	IEC 60749-19:2003 +AMD1:2010	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 19: Die shear strength
137.	IEC 60749-20:2020	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 20: Resistance of plastic encapsulated SMDs to the combined effect of moisture and soldering heat
138.	IEC 60749-20-1:2019	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 20-1: Handling, packing, labelling and shipping of surface-mount devices sensitive to the combined effect of moisture and soldering heat
139.	IEC 60749-21:2011	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 21: Solderability
140.	IEC 60749-22:2002	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 22: Bond strength

141.	IEC 60749-23:2004 +AMD1:2011	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 23: High temperature operating life
142.	IEC 60749-24:2004	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 24: Accelerated moisture resistance - Unbiased HAST
143.	IEC 60749-25:2003	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 25: Temperature cycling
144.	IEC 60749-26:2018	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 26: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing - Human body model (HBM)
145.	IEC 60749-27:2006 +AMD1:2012	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 27: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing - Machine model (MM)
146.	IEC 60749-28:2022	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 28: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing - Charged device model (CDM) - device level
147.	IEC 60749-29:2011	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 29: Latch-up test
148.	IEC 60749-30:2020	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 30: Preconditioning of non-hermetic surface mount devices prior to reliability testing
149.	IEC 60749-31:2002	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 31: Flammability of plastic-encapsulated devices (internally induced)
150.	IEC 60749-32:2002 +AMD1:2010	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 32: Flammability of plastic-encapsulated devices (externally induced)
151.	IEC 60749-33:2004	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 33: Accelerated moisture resistance - Unbiased autoclave
152.	IEC 60749-34:2010	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 34: Power cycling
153.	IEC 60749-35:2006	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 35: Acoustic microscopy for plastic encapsulated electronic components
154.	IEC 60749-36:2003	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 36: Acceleration, steady state
155.	IEC 60749-37:2022	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 37: Board level drop test method using an accelerometer
156.	IEC 60749-38:2008	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 38: Soft error test method for semiconductor devices with memory
157.	IEC 60749-39:2021	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 39: Measurement of moisture diffusivity and water solubility in organic materials used for semiconductor components
158.	IEC 60749-40:2011	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 40: Board level drop test method using a strain gauge
159.	IEC 60749-41:2020	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 41: Standard reliability testing methods of non-volatile memory devices
160.	IEC 60749-42:2014	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 42: Temperature and humidity storage

161.	IEC 60749-44:2016	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 44: Neutron beam irradiated single event effect (SEE) test method for semiconductor devices
162.	IEC 62047-28:2017	Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 28: Performance testing method of vibration-driven MEMS electret energy harvesting devices
163.	IEC 62258-1:2009	Semiconductor die products - Part 1: Procurement and use
164.	IEC 62258-2:2011	Semiconductor die products - Part 2: Exchange data formats
165.	IEC TR 62258-3:2010	Semiconductor die products - Part 3: Recommendations for good practice in handling, packing and storage
166.	IEC TR 62258-4:2012	Semiconductor die products - Part 4: Questionnaire for die users and suppliers
167.	IEC 62258-5:2006	Semiconductor die products - Part 5: Requirements for information concerning electrical simulation
168.	IEC 62258-6:2006	Semiconductor die products - Part 6: Requirements for information concerning thermal simulation
169.	IEC TR 62258-7:2007	Semiconductor die products - Part 7: XML schema for data exchange
170.	IEC TR 62258-8:2008	Semiconductor die products - Part 8: EXPRESS model schema for data exchange
171.	IEC 62373:2006	Bias-temperature stability test for metal-oxide, semiconductor, field-effect transistors (MOSFET)
172.	IEC 62373-1:2020	Semiconductor devices - Bias-temperature stability test for metal-oxide, semiconductor, field-effect transistors (MOSFET) - Part 1: Fast BTI test for MOSFET
173.	IEC 62374:2007	Semiconductor devices - Time dependent dielectric breakdown (TDDB) test for gate dielectric films
174.	IEC 62374-1:2010	Semiconductor devices - Part 1: Time-dependent dielectric breakdown (TDDB) test for inter-metal layers
175.	IEC 62415:2010	Semiconductor devices - Constant current electromigration test
176.	IEC 62416:2010	Semiconductor devices - Hot carrier test on MOS transistors
177.	IEC 62417:2010	Semiconductor devices - Mobile ion tests for metal-oxide semiconductor field effect transistors (MOSFETs)
178.	IEC 62418:2010	Semiconductor devices - Metallization stress void test
179.	IEC 62435-1:2017	Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 1: General
180.	IEC 62435-2:2017	Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 2: Deterioration mechanisms
181.	IEC 62435-3:2020	Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 3: Data
182.	IEC 62435-4:2018	Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 4: Storage
183.	IEC 62435-5:2017	Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 5: Die and wafer devices
184.	IEC 62435-6:2018	Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 6: Packaged or finished devices

185.	IEC 62435-7:2020	Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 7: Micro-electromechanical devices
186.	IEC 62435-8:2020	Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 8: Passive electronic devices
187.	IEC 62435-9:2021	Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 9: Special cases
188.	IEC 62483:2013	Environmental acceptance requirements for tin whisker susceptibility of tin and tin alloy surface finishes on semiconductor devices
189.	IEC 62615:2010	Electrostatic discharge sensitivity testing - Transmission line pulse (TLP) - Component level
190.	IEC 62779-1:2016	Semiconductor devices - Semiconductor interface for human body communication - Part 1: General requirements
191.	IEC 62779-2:2016	Semiconductor devices - Semiconductor interface for human body communication - Part 2: Characterization of interfacing performances
192.	IEC 62779-3:2016	Semiconductor devices - Semiconductor interface for human body communication - Part 3: Functional type and its operational conditions
193.	IEC 62779-4:2020	Semiconductor devices - Semiconductor interface for human body communication - Part 4: Capsule endoscope
194.	IEC 62830-1:2017	Semiconductor devices - Semiconductor devices for energy harvesting and generation - Part 1: Vibration based piezoelectric energy harvesting
195.	IEC 62830-2:2017	Semiconductor devices - Semiconductor devices for energy harvesting and generation - Part 2: Thermo power based thermoelectric energy harvesting
196.	IEC 62830-3:2017	Semiconductor devices - Semiconductor devices for energy harvesting and generation - Part 3: Vibration based electromagnetic energy harvesting
197.	IEC 62830-4:2019	Semiconductor devices - Semiconductor devices for energy harvesting and generation - Part 4: Test and evaluation methods for flexible piezoelectric energy harvesting devices
198.	IEC 62830-5:2021	Semiconductor devices - Semiconductor devices for energy harvesting and generation - Part 5: Test method for measuring generated power from flexible thermoelectric devices
199.	IEC 62830-6:2019	Semiconductor devices - Semiconductor devices for energy harvesting and generation - Part 6: Test and evaluation methods for vertical contact mode triboelectric energy harvesting devices
200.	IEC 62830-7:2021	Semiconductor devices - Semiconductor devices for energy harvesting and generation - Part 7: Linear sliding mode triboelectric energy harvesting
201.	IEC 62830-8:2021	Semiconductor devices - Semiconductor devices for energy harvesting and generation - Part 8: Test and evaluation methods of flexible and stretchable supercapacitors for use in low power electronics
202.	IEC 62880-1:2017	Semiconductor devices - Stress migration test standard - Part 1: Copper stress migration test standard

203.	IEC 62951-1:2017	Semiconductor devices - Flexible and stretchable semiconductor devices - Part 1: Bending test method for conductive thin films on flexible substrates
204.	IEC 62951-2:2019	Semiconductor devices - Flexible and stretchable semiconductor devices - Part 2: Evaluation method for electron mobility, sub-threshold swing and threshold voltage of flexible devices
205.	IEC 62951-3:2018	Semiconductor devices - Flexible and stretchable semiconductor devices - Part 3: Evaluation of thin film transistor characteristics on flexible substrates under bulging
206.	IEC 62951-4:2019	Semiconductor devices - Flexible and stretchable semiconductor devices - Part 4: Fatigue evaluation for flexible conductive thin film on the substrate for flexible semiconductor devices
207.	IEC 62951-5:2019	Semiconductor devices - Flexible and stretchable semiconductor devices - Part 5: Test method for thermal characteristics of flexible materials
208.	IEC 62951-6:2019	Semiconductor devices - Flexible and stretchable semiconductor devices - Part 6: Test method for sheet resistance of flexible conducting films
209.	IEC 62951-7:2019	Semiconductor devices - Flexible and stretchable semiconductor devices - Part 7: Test method for characterizing the barrier performance of thin film encapsulation for flexible organic semiconductor
210.	IEC 62951-8:2023	Semiconductor devices - Flexible and stretchable semiconductor devices - Part 8: Test method for stretchability, flexibility, and stability of flexible resistive memory
211.	IEC 62951-9:2022	Semiconductor devices - Flexible and stretchable semiconductor devices - Part 9: Performance testing methods of one transistor and one resistor (1T1R) resistive memory cells
212.	IEC 62969-1:2017	Semiconductor devices - Semiconductor interface for automotive vehicles - Part 1: General requirements of power interface for automotive vehicle sensors
213.	IEC 62969-2:2018	Semiconductor devices - Semiconductor interface for automotive vehicles - Part 2: Efficiency evaluation methods of wireless power transmission using resonance for automotive vehicles sensors
214.	IEC 62969-3:2018	Semiconductor devices - Semiconductor interface for automotive vehicles - Part 3: Shock driven piezoelectric energy harvesting for automotive vehicle sensors
215.	IEC 62969-4:2018	Semiconductor devices - Semiconductor interface for automotive vehicles - Part 4: Evaluation method of data interface for automotive vehicle sensors
216.	IEC 63068-1:2019	Semiconductor devices - Non-destructive recognition criteria of defects in silicon carbide homoepitaxial wafer for power devices - Part 1: Classification of defects
217.	IEC 63068-2:2019	Semiconductor devices - Non-destructive recognition criteria of defects in silicon carbide homoepitaxial wafer for power devices - Part 2: Test method for defects using optical inspection

218.	IEC 63068-3:2020	Semiconductor devices - Non-destructive recognition criteria of defects in silicon carbide homoepitaxial wafer for power devices - Part 3: Test method for defects using photoluminescence
219.	IEC 63068-4:2022	Semiconductor devices - Non-destructive recognition criteria of defects in silicon carbide homoepitaxial wafer for power devices - Part 4: Procedure for identifying and evaluating defects using a combined method of optical inspection and photoluminescence
220.	IEC TR 63133:2017	Semiconductor devices - Scan based ageing level estimation for semiconductor devices
221.	IEC 63150-1:2019	Semiconductor devices - Measurement and evaluation methods of kinetic energy harvesting devices under practical vibration environment - Part 1: Arbitrary and random mechanical vibrations
222.	IEC 63229:2021	Semiconductor devices - Classification of defects in gallium nitride epitaxial film on silicon carbide substrate
223.	IEC 63244-1:2021	Semiconductor devices - Semiconductor devices for wireless power transfer and charging - Part 1: General requirements and specifications
224.	IEC 63275-1:2022	Semiconductor devices - Reliability test method for silicon carbide discrete metal-oxide semiconductor field effect transistors - Part 1: Test method for bias temperature instability
225.	IEC 63275-2:2022	Semiconductor devices - Reliability test method for silicon carbide discrete metal-oxide semiconductor field effect transistors - Part 2: Test method for bipolar degradation due to body diode operation
226.	IEC 63284:2022	Semiconductor devices - Reliability test method by inductive load switching for gallium nitride transistors
227.	IEC 63287-1:2021	Semiconductor devices - Generic semiconductor qualification guidelines - Part 1: Guidelines for IC reliability qualification
228.	IEC 63287-2:2023	Semiconductor devices - Guidelines for reliability qualification plans - Part 2: Concept of mission profile
229.	IEC TR 63357:2022	Semiconductor devices - Standardization roadmap of fault test method for automotive vehicles
230.	IEC 63364-1:2022	Semiconductor devices - Semiconductor devices for IoT system - Part 1: Test method of sound variation detection
231.	IEC 63373:2022	Dynamic on-resistance test method guidelines for GaN HEMT based power conversion devices
232.	IEC 63505:2025	Guidelines for measuring the threshold voltage (VT) of SiC MOSFETs

**Проект перспективной программы по стандартизации (работ) межгосударственного комитета по стандартизации № 567 «Сверхвысокочастотная и силовая электроника» на 2026-2030 гг.**

№ п/п	Шифр темы в программе межгосударственной и/или национальной стандартизации	Наименование документа	Вид работ <sup>1</sup>	Государство – член МГС – ответственный разработчик	Сроки разработки		Профильный (ответственный)/с межный ТК
					начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Будет уточнено в ходе выполнения работ	Технологии АЗБ5. Пластины с кристаллами заказных элементов. Термины и определения	Разработка ГОСТ на основе ГОСТ Р 71584-2024	Российская Федерация	10.2026	12.2028	МТК 567
2.	Будет уточнено в ходе выполнения работ	Устройства преобразования энергии на основе нитрида галлия. Методы оценки срока службы. Общие положения	Разработка ГОСТ на основе ГОСТ Р 71548-2024	Российская Федерация	10.2026	12.2028	МТК 567
3.	Будет уточнено в ходе выполнения работ	Устройства преобразования энергии на основе нитрида галлия. Метод измерений для оценки непрерывного переключения	Разработка ГОСТ на основе ГОСТ Р 71155-2023	Российская Федерация	10.2026	12.2028	МТК 567
4.	Будет уточнено в ходе выполнения работ	Транзисторы биполярные СВЧ генераторные. Методы измерения выходной мощности и определения коэффициента усиления по мощности и коэффициента полезного действия коллектора	Пересмотр ГОСТ 18604.13-77	Российская Федерация	04.2027	07.2029	МТК 567
5.	Будет уточнено в ходе выполнения работ	Транзисторы биполярные СВЧ генераторные. Метод измерения модуля коэффициента обратной передачи напряжения в схеме с общей базой на высокой частоте	Пересмотр ГОСТ 18604.14-77	Российская Федерация	04.2027	07.2029	МТК 567

<sup>1</sup> В случае проведения работ по гармонизации с международными/региональными требованиями, версия международного/регионального стандарта, в соответствии с которой будет проводиться разработка стандарта, может быть изменена на более актуальную, действующую на момент проведения разработки

6.	Будет уточнено в ходе выполнения работ	Транзисторы биполярные СВЧ генераторные. Методы измерения критического тока	Пересмотр ГОСТ 18604.15-77	Российская Федерация	04.2027	07.2029	МТК 567
7.	Будет уточнено в ходе выполнения работ	Диоды полупроводниковые СВЧ. Методы измерения электрических параметров. Общие положения	Пересмотр ГОСТ 19656.0-74	Российская Федерация	02.2028	04.2030	МТК 567
8.	Будет уточнено в ходе выполнения работ	Диоды полупроводниковые сверхвысокочастотные. Общие технические условия	Пересмотр ГОСТ 20215-84	Российская Федерация	02.2028	04.2030	МТК 567

Утверждено

Межгосударственным советом по  
стандартизации, метрологии и сертификации

протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о межгосударственном**

**техническом комитете по стандартизации**

**«СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНАЯ И СИЛОВАЯ  
ЭЛЕКТРОНИКА»**

**МТК 567**

## ПОЛОЖЕНИЕ

### о межгосударственном техническом комитете по стандартизации «Сверхвысокочастотная и силовая электроника»

#### 1. Общие положения

1.1. Межгосударственный технический комитет по стандартизации МТК 567 «Сверхвысокочастотная и силовая электроника» (далее – МТК 567) является формой сотрудничества заинтересованных государств при проведении работ по межгосударственной стандартизации в области деятельности, закрепленной за МТК 567 и указанной в протоколе Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (далее – МГС).

1.2. Решение о создании МТК 567 принято МГС протокол № \_\_ от \_\_.2025 г. При этом утверждена структура и состав МТК 567, перечень межгосударственных стандартов, закрепленных за МТК 567, и перечень международных (и/или европейских) стандартов, относящихся к области деятельности МТК 567, а также одобрена перспективная программа работы МТК 567 и назначены:

- председатель МТК 567 – Рулевский Виктор Михайлович, ректор Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (ФГАОУ ВО «ТУСУР»), председатель Технического комитета по стандартизации «Сверхвысокочастотная и силовая электроника» (ТК 328), Адрес электронной почты: rector@tusur.ru; телефон: +7 (3822) 51-05-30;

- заместитель председателя МТК 567 – Мурсалимова Нэлля Витальевна, директор Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области» (ФБУ «Томский ЦСМ»), заместитель председателя Технического комитета по стандартизации «Сверхвысокочастотная и силовая электроника» (ТК 328), адрес электронной почты: mursalimovanv@tcsms.tomsk.ru; телефон: +7 (3822) 55-44-86;

- заместитель председателя МТК 567 – Гаевой Евгений Васильевич, помощник ректора ФГАОУ ВО «ТУСУР», директор Центра коллективного проектирования «СВЧ микроэлектроника и радиофотоника», заместитель председателя Технического комитета по стандартизации «Сверхвысокочастотная и силовая электроника» (ТК 328), адрес электронной почты: gaevoye@mail.ru; телефон: +7 (913) 850-99-95;

- ответственный секретарь МТК 567 – Лиепиньш Татьяна Викторовна, ведущий инженер по качеству ФБУ «Томский ЦСМ»; ответственный секретарь Технического комитета по стандартизации «Сверхвысокочастотная и силовая электроника» (ТК 328), адрес электронной почты: liepinshtv@tcsms.tomsk.ru; телефон: +7 (3822) 55-44-86.

1.3. Методическое руководство работой МТК 567 и контроль за его деятельностью осуществляют Бюро по стандартам и национальный орган по стандартизации Российской Федерации.

1.4. Работой МТК 567 руководит председатель комитета, а организационно-технические функции выполняют ответственный секретарь и секретариат МТК 567.

1.5. Ведение секретариата МТК 567 поручено Федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «Институт стандартизации»), который осуществляет материальное и организационное обеспечение его деятельности.

1.6. Для переписки МТК 567 имеет свой бланк с набором необходимых реквизитов. Право подписи писем на бланке комитета имеют председатель МТК 567, его заместитель и ответственный секретарь МТК 567.

1.7. В своей деятельности МТК 567 руководствуется ГОСТ 1.0, ГОСТ 1.2, ГОСТ 1.6, другими основополагающими межгосударственными стандартами, правилами и рекомендациями по межгосударственной стандартизации, решениями МГС, которые распространяются на деятельность МТК.

1.8. МТК 567 принимает свои решения на заседании комитета в очном или заочном режиме с соблюдением правил и рекомендаций, установленных в ГОСТ 1.4-2020 (пункт 7.5, приложение Д).

1.9. Решения об изменении области деятельности МТК 567 принимает МГС на основании предложений РГ МТК и (или) НТКС.

1.10. Решения об изменении структуры и состава МТК 567, в том числе об изменении статуса членов, приеме новых членов или исключении членов из состава комитета принимают на заседании МТК на основании заявлений национальных органов заинтересованных государств или предложений председателя МТК 567.

1.11. Решение о начале реорганизации или расформировании МТК 567 может быть принято на заседании данного комитета, а окончательное решение о реорганизации или расформировании МТК 567 – на заседании МГС.

## **2. Задачи и функции**

2.1. МТК 567 решает основные задачи, которые указаны в ГОСТ 1.4-2020 (пункт 4.1.2).

2.2. Кроме основных МТК 567 решает также дополнительные задачи, если соответствующее решение будет принято на заседании МГС или МТК 567.

2.3. В процессе своей деятельности МТ 567 выполняет работы, которые указаны в ГОСТ 1.4-2020 (раздел 6).

### **3. Обязанности**

3.1. Председатель МТК 567 обязан выполнять функции, установленные в ГОСТ 1.4 (пункт 7.2.1).

3.2. Заместитель председателя МТК 567 обязан выполнять функции, делегированные ему председателем комитета, а в его отсутствие выполнять функции председателя МТК 567.

3.3. Ответственный секретарь и секретариат МТК 567 обязаны выполнять функции, установленные в ГОСТ 1.4-2020 (раздел 7.2.3).

3.4. Председатель МТК 567, заместитель председателя и ответственный секретарь должны учитывать в своей работе интересы всех государств – полноправных членов комитета.

3.5. Полномочные представители полноправных членов МТК 567 обязаны:

- участвовать во всех заседаниях комитета;
- рассматривать проекты межгосударственных стандартов, проекты изменений межгосударственных стандартов и готовить отзывы на указанные проекты или сообщать о незаинтересованности в их применении;
- рассматривать предложения об отмене закрепленных за МТК 567 межгосударственных стандартов;
- участвовать в голосовании по окончательным редакциям проектов межгосударственных стандартов и проектов изменений межгосударственных стандартов, а также по предложениям МТК в программу межгосударственной стандартизации;
- оперативно сообщать в секретариат МТК 567 сведения о введении в действие в своих государствах принятых межгосударственных стандартах и об одностороннем прекращении их действия;
- оперативно сообщать в секретариат МТК 567 об изменении своих реквизитов или замене полномочного представителя.

3.6. Для полномочных представителей членов МТК 567 в статусе наблюдателей обязательства не устанавливаются, за исключением обязательства оперативно сообщать в секретариат МТК 567 об изменении своих реквизитов.

### **4. Права**

4.1. Полномочные представители полноправных членов МТК 567 имеют право:

- а) участвовать во всех работах, проводимых МТК 567;
- б) получать для рассмотрения проекты межгосударственных стандартов и проекты изменений и давать на них отзывы;
- в) участвовать в обсуждении проектов межгосударственных стандартов и проектов изменений этих стандартов, предложений об отмене закрепленных за МТК 567 стандартов и прочих предложений, которые рассматривает МТК 567 в

соответствии с ГОСТ 1.4-2020 (раздел 6, 7), организационных и иных вопросов на заседании МТК 567 (в очном или заочном режимах);

г) голосовать по указанным проектам и предложениям, а также по организационным и иным вопросам работы МТК 567;

д) воздерживаться при голосовании по указанным проектам в случае незаинтересованности в их применении;

е) давать предложения о разработке и обновлении межгосударственных стандартов, а также предложения по отмене закрепленных за МТК 567 межгосударственных стандартов;

ж) предложить секретариату МТК 567 вынести на заседание комитета обсуждение организационного или любого иного вопроса, касающегося деятельности МТК 567, в случае, предусмотренном в ГОСТ 1.4-2020 (пункт 7.6.3), обратиться в Бюро по стандартам с заявлением о необходимости принятия мер по обеспечению надлежащей работы комитета;

и) подать апелляцию на неправомочное решение МТК 567 в соответствии с ГОСТ 1.4 (пункт 7.6.4);

к) на доступ к функционалу ИСС МГС и к информационным данным МТК 567;

л) получать от секретариата МТК 567 информационные материалы.

4.2. Полномочные представители членов МТК 567 в статусе наблюдателей имеют права, указанные в 4.1, - в перечислениях а) – в), е), к), л).

4.3. Национальные органы членов МТК 567 имеют право:

- изменить статус полноправного члена комитета на наблюдателя;
- изменить статус наблюдателя на полноправного члена МТК 567;
- выйти из состава данного комитета.

4.4. Председатель МТК 567 и ответственный секретарь комитета имеют право:

- представлять МТК 567 в других МТК, на заседаниях МГС, его комиссий и РГ МТК;
- организовать проведение очередного заседания МТК 567;
- созвать для решения срочных вопросов внеочередное заседание МТК 567 или провести его заочно;
- выдвигать предложения по созданию подкомитетов и рабочих групп, принятию новых членов МТК 567, исключению членов комитета, не выполняющих свои обязанности;
- отказаться от исполнения обязанностей председателя МТК 567 или ответственного секретаря комитета.

4.5. Председатель МТК 567 имеет право сформировать рабочую группу для совместной разработки и (или) обновления межгосударственных стандартов в случае необходимости срочного решения данной задачи.

4.6. Право голоса от имени государства, ведущего секретариат МТК 567, имеет лицо, назначенное национальным органом этого государства.

**Перечень существующих межгосударственных стандартов, которые предлагается закрепить за МТК**

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
1	ГОСТ 4.137-85	Система показателей качества продукции. Приборы полупроводниковые силовые. Номенклатура показателей
2	ГОСТ 4.172-85	Система показателей качества продукции. Конденсаторы силовые, установки конденсаторные. Номенклатура показателей
3	ГОСТ 18604.13-77	Транзисторы биполярные СВЧ генераторные. Методы измерения выходной мощности и определения коэффициента усиления по мощности и коэффициента полезного действия коллектора
4	ГОСТ 18604.14-77	Транзисторы биполярные СВЧ генераторные. Метод измерения модуля коэффициента обратной передачи напряжения в схеме с общей базой на высокой частоте
5	ГОСТ 18604.15-77	Транзисторы биполярные СВЧ генераторные. Методы измерения критического тока
6	ГОСТ 19656.0-74	Диоды полупроводниковые СВЧ. Методы измерения электрических параметров. Общие положения
7	ГОСТ 19656.1-74	Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные и детекторные. Метод измерения коэффициента стоячей волны по напряжению
8	ГОСТ 19656.2-74	Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные. Метод измерения выпрямленного тока
9	ГОСТ 19656.3-74	Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные. Методы измерения выходного сопротивления на промежуточной частоте
10	ГОСТ 19656.4-74	Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные. Методы измерения потерь преобразования
11	ГОСТ 19656.5-74	Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные и детекторные. Методы измерения шумового отношения
12	ГОСТ 19656.6-74	Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные. Методы измерения нормированного коэффициента шума
13	ГОСТ 19656.7-74	Диоды полупроводниковые СВЧ детекторные. Метод измерения чувствительности по току

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
14	ГОСТ 19656.9-79	Диоды полупроводниковые СВЧ параметрические и умножительные. Методы измерения постоянной времени и предельной частоты
15	ГОСТ 19656.10-88	Диоды полупроводниковые сверхвысокочастотные переключательные и ограничительные. Методы измерения сопротивлений потерь
16	ГОСТ 19656.12-76	Диоды полупроводниковые СВЧ смесительные. Метод измерения полного входного сопротивления
17	ГОСТ 19656.13-76	Диоды полупроводниковые СВЧ детекторные. Методы измерения тангенциальной чувствительности
18	ГОСТ 19656.14-79	Диоды полупроводниковые СВЧ переключательные. Метод измерения критической частоты
19	ГОСТ 19656.15-84	Диоды полупроводниковые СВЧ. Методы измерения теплового сопротивления переход-корпус и импульсного теплового сопротивления
20	ГОСТ 19656.16-86	Диоды полупроводниковые СВЧ ограничительные. Метод измерения пороговой и просачивающейся мощностей
21	ГОСТ 20215-84	Диоды полупроводниковые сверхвысокочастотные. Общие технические условия
22	ГОСТ 20271.1-91	Изделия электронные СВЧ. Методы измерения электрических параметров
23	ГОСТ 20271.3-91	Изделия электронные СВЧ. Методы измерения параметров модулирующего импульса
24	ГОСТ 20859.1-89	Приборы полупроводниковые силовые. Общие технические требования
25	ГОСТ 21702-76	Устройства СВЧ. Полосковые линии. Термины и определения
26	ГОСТ 23221-78	Модули СВЧ, блоки СВЧ. Термины, определения и буквенные обозначения
27	ГОСТ 23769-79	Приборы электронные и устройства защитные СВЧ. Термины, определения и буквенные обозначения
28	ГОСТ 23900-87	Приборы полупроводниковые силовые. Габаритные и присоединительные размеры
29	ГОСТ 24461-80	Приборы полупроводниковые силовые. Методы измерений и испытаний
30	ГОСТ 27264-87	Транзисторы силовые биполярные. Методы измерений

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
31	ГОСТ 27591-88	Модули полупроводниковые силовые. Габаритные и присоединительные размеры
32	ГОСТ 29002-91 (МЭК 723-4-87)	Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, применяемых в аппаратуре дальней связи. Часть 4. Групповые технические условия на сердечники из магнитных оксидных материалов для трансформаторов и дросселей, предназначенных для применения в силовых устройствах
33	ГОСТ 29003-91 (МЭК 723-4-1-87)	Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, применяемых в аппаратуре дальней связи. Часть 4. Форма технических условий на сердечники конкретных типов из магнитных оксидных материалов для трансформаторов и дросселей, предназначенных для применения в силовых устройствах. Уровень качества А
34	ГОСТ 30617-98	Модули полупроводниковые силовые. Общие технические условия
35	ГОСТ ИЕС 60931-1-2013	Конденсаторы шунтирующие силовые несамовосстанавливающегося типа для систем переменного тока на номинальное напряжение до 1000 В включительно. Часть 1. Общие положения. Рабочие характеристики, испытания и номинальные параметры. Требования техники безопасности. Руководство по установке и эксплуатации
36	ГОСТ ИЕС 60931-2-2013	Конденсаторы шунтирующие силовые несамовосстанавливающиеся для систем с переменным током и номинальным напряжением до 1000 В включительно. Часть 2. Испытание на старение и испытание на разрушение
37	ГОСТ ИЕС 60931-3-2013	Конденсаторы шунтирующие силовые несамовосстанавливающиеся для систем переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В включительно. Часть 3. Внутренние плавкие предохранители
38	ГОСТ ИЕС 61071-2014	Конденсаторы силовые электронные
39	ГОСТ ИЕС 61921-2013	Конденсаторы силовые. Конденсаторные батареи для коррекции коэффициента мощности при низком напряжении